

2023年8月1日

アドバンテック株式会社

DDR4 3200 SODIMM & RDIMM Micron E-Die 終息のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

掲題の件に関しまして、Micron ICロードマップに従って、Micron DDR4 3200 1Znm IC チップはフェイズ・アウトされ、次世代 1anm に移行する予定です。DDR4 3200 SODIMM & RDIMM Micron E-Die の EOL 計画を発表します。

DDR4 3200 SODIMM 4GB Micron E-Die は Samsung C-Die に移行します。

8GB と 16GB は Micron R-Die に移行します。

32GB は Micron Fdie に移行します。

RDIMM は Samsung IC に移行します。

終息パーツ：

- 1) Micron DDR4 3200MT/s E-Die SODIMM
- 2) Micron DDR4 3200MT/s E-Die RDIMM

下記の型番の製品終息に伴う、対策後継型番を通知させていただきます。

(1) 対象製品型番、後継型番表：

Model	EOL Announcement	Last Time Buy (EOL) Date	The Last Shipment Date	Replacement
SQR-SD4N4G3K2MNPEA	2023/8/1	2023/12/28	2024/2/28	SQR-SD4N4G3K2SNPCB
SQR-SD4N8G3K2MNGEA	2023/8/1	2023/12/28	2024/2/28	SQR-SD4N8G3K2MNB RB
SQR-SD4N8G3K2MNBEA	2023/8/1	2023/12/28	2024/2/28	SQR-SD4N8G3K2MNB RB
SQR-SD4N16G3K2MNEA	2023/8/1	2023/12/28	2024/2/28	SQR-SD4N16G3K2MNB RB
SQR-SD4N32G3K2MNEA	2023/8/1	2023/12/28	2024/2/28	SQR-SD4N32G3K2MNB FB
SQR-RD4N8G3K2MZBEA	2023/8/1	2023/12/28	2024/2/28	SQR-RD4N8G3K2SZBCB
SQR-RD4N16G3K2MZE A	2023/8/1	2023/12/28	2024/2/28	SQR-RD4N16G3K2SZCB
SQR-RD4N32G3K2MZE A	2023/8/1	2023/12/28	2024/2/28	SQR-RD4N32G3K2SZAB

(2) 変更の理由：

Micron IC ロードマップに従って、Micron DDR4 3200 1Znm IC チップ はフェイズ・アウトされ、次世代 1anm に移行する予定です

(3) 変更スケジュール：

内容	日時
終息のお知らせ	2023年8月1日
正式な製品の廃止日程および製品の受注締め切り日	2023年12月28日
製品の最終出荷日	2024年2月28日

尚、本ご案内に関するお問合せは、次のようにお願い致します。

- 販売代理店様からご購入された場合
 - ー 販売代理店様へお問い合わせください。
- ご購入いただいた販売代理店様がわからない場合、弊社から直接ご購入された場合
 - ー 以下弊社窓口へ直接お問い合わせください。

アドバンテック株式会社マーケティング部

〒111-0032東京都台東区浅草6-16-3

E-mail: ajp_callcenter@advantech.com

TEL: 0800-500-1055 (フリーダイヤル) FAX: :03-6802-10222